市場調査レポートのご案内

AI用半導体パッケージ＆PCBの技術/市場動向

発刊予定：2026年10月26日、A4判/130頁

株式会社ジャパンマーケティングサーベイ

103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル8F

www.jms21.co.jp Tel: 03-5829-3891

調査概要

◆ 調査の背景/発刊目的

爆発的な拡大を見せるAI市場において、そのソフトも当然ですが、半導体及びその周辺電子技術も今後AI普及におけるキーテクノロジーと云えます。

当レポートではAIサーバーを頂点に、AI用半導体→ICパッケージ→サブストレート/インターポーザ→PCB/CCLまで幅広く調査対象として、その技術/市場動向を俯瞰的に把握する事で、関係業界の方々の戦略立案に約立つ事を目的とします。

◆ 調査の対象

詳細は次頁ご参照ください

◆ 調査の方法

関係企業への直接取材/アンケートサーベイ、公開情報の収集等

◆ 調査の内容

詳細は次々頁以降をご参照ください

調査の対象

対象製品	分 類	対象企業
AIサーバー	学習/推論（大規模/中規模以下）、 GPU系/Accelerator ASIC系	ブランドメーカ：Dell/Supermicro/HPE 組立メーカ：Foxconn/Quanta/Wistron
AI用半導体及び ICパッケージング	GPU/ASIC, MPU, NIC/DPU用IC, Switch IC, HBM FCBGA/2.x D: 2.1/2.3/2.5	NVIDIA/AMD/Google/AWS/Broadcom/ TSMC
サブストレート/ インターポーザ	FCBGA基板：樹脂コア/ガラスコア Interposer: Si/Organic/Glass	イビデン/Unimicron/Nan Ya/Kinsus/新光電気 /SEMCO/Toppan/
PCB	AI Compute基板/AI Switch基板/ToR Switch基板/Midplane基板	VGT/GCE/WUS/Unimicron/Shengyi/TTM/ ISU Petasys/Multek/Founder/Shennan/ ZDT/Hannstar/Kinwong
CCL	Dfクラス@10GHz： Enhanced Extreme Low Loss: < 0.0010 Extreme Low Loss: 0.0010-0.0015 Ultra Low Loss: 0.0016-0.0030 Very Low Loss: 0.0031-0.0055 Low Loss: 0.0056-0.0079	EMC/Doosan/SYTECH/Panasonic/ITEQ/ WAZAM/TUC

調査の内容/項目

第１章 サマリー
1. 各AI関連製品の市場規模推移と予測（2025-2035年、数量/金額）
2. バリューチェイン分析、技術動向

第2章 AI Serverの市場動向
1. AI Serverの概要（製品分類/概要、各社製品のトレイ構成、Server Scale/Rack Scale)
2. AI Serverの市場規模推移と予測：2023-2035、数量/金額、学習/推論（大規模/中規模以下別）
3. AI Serverメーカの動向
 - メーカ別シェア：ブランドメーカ別/組立メーカ別/エンドユーザ別
 - 個別企業動向：Dell, Supermicro, HPE, Foxconn, Quanta, Wistron

第3章 AI Server用半導体の市場動向
1. AC用半導体の概要：種類/分類、Accelerator ICの概要、MPUの概要、Switch ICの概要
2. AIサーバー用半導体の搭載数動向：学習サーバ/推論サーバ別
3. AIサーバー用半導体の市場動向（2023-2035、数量/金額、個別半導体別）
   - 個別半導体：GPU/ASIC, NIC/DPU, Switch IC, MPU, HBM
4. AI Server用半導体の主要企業動向
   - メーカ別シェア：GPU/ASIC, NIC/DPU, Switch IC, MPU, HBM

第4章 AI Server用半導体パッケージの技術・市場動向
1. 各半導体のパッケージ技術：GPU/ASIC, NIC/DPU, Switch IC, MPU, HBM
2. 各半導体のパッケージ種類別市場規模予測：2023-2035，数量、FCBGA/2.1D/2.3D/2.5D
3. パッケージング技術動向：GPU/ASIC, NIC/DPU, Switch IC, MPU, HBM
4.インターポーザの技術動向（Si Interposer/Glass Interposer/Organic Interposer）

調査の内容/項目

第5章 AI用ICサブストレートの技術/市場動向

1. 各半導体別FCBGA基板の概要
2. AI Server 向けFCBGA基板の市場規模予測: 2023-2035、数量/金額、
   1) 各種半導体別：GPU/ASIC基板、MPU基板、Switch IC基板
   2) 層数別：16－18層/20－22層/24-26層/28-30層
3. サブストレートメーカの動向
   1) 主要メーカ別販売実績（数量/金額）、シェア
   2) 各企業動向：イビデン/Unimicron/Nan Ya/Kinsus/新光電気/SEMCO
4. 技術動向：GPU/ASIC基板、MPU基板、Switch IC基板

第6章 AI Server用PCB/CCLの技術/市場動向

1. AI Server用基板の概要：AI Compute基板/AI Switch基板/ToR Switch基板/Midplane基板
2. 種類別AI Server用PCBの市場規模推移と予測：2023-2025年、数量/金額
3. AI Server用PCBメーカの動向
   1) 基板種類別主要メーカの販売実績（数量/金額）、メーカ別シェア
   2) 主要各社の動向：VGT/GCE/WUS/Unimicron/Shengyi/TTM
4. AI Server用CCLの動向
   1) 製品概要
   2) Df別市場規模推移と予測：数量/金額、2023-2035年
   3) 主要企業販売実績（数量/金額）、メーカ別シェア

申込要項等

▼ 価格（税込）

コーポレート契約：594,000円、グローバル契約：792,000円

※コーポレート契約：レポートの使用範囲は同一法人内に限定されます。

※グローバル契約：出資比率51%以上の子会社までの利用範囲となります。

▼ 申込方法

添付の申込書に所定事項をご記入の上電子メールにて返信ください。(info@jms21.co.jp)
また、弊社Websiteからもご注文可能です。www.jms21.co.jp

▼ 支払方法

お申込み受領後3日以内（営業日換算）に請求書をレポートと同封でお送りいたします。

お支払いは請求日の翌月末日までに銀行振り込みにてお願いいたします。

▼ 納品形態

製本レポート：1部、PDFファイル

▼ 調査レポートのお取り扱いについて

コーポレート/グローバル契約の各利用範囲の限定を守っていただく事、及び当レポートにおける弊社の著作権/版権を侵害しない事をお約束いただきます。

申込書：AI用半導体パッケージ＆PCB

年　　月　　日

株式会社ジャパンマーケティングサーベイ 様

契約形態：□コーポレート契約　□グローバル契約

※前頁の調査資料の取扱いについて同意の上、契約形態を選択の上☑を入れて下さい

申込企業名：

所在地：　〒

申込者：　　印　連絡担当者：

同所属：

Email　：

TEL　：

連絡事項等：